

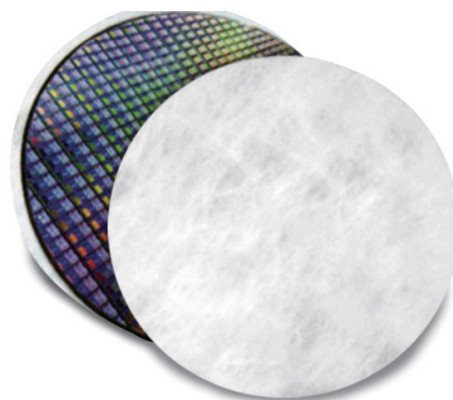


◀DUPONT▶  
**Tyvek**®

**タイベック®製 インターリーフ/ウェハースペーサー**  
精密電子機器の保護を確固なものにするために

## 直面する課題:

半導体製造に使用される精密な電子部品は、パーティクル、傷、イオンコンタミ、そして静電気によってダメージを受けてしまいます。また、真空下での取り扱いも課題となります。ウェハー包装業者や集積回路(IC)を設計する企業は、半導体に一般的なそれらの問題に対応できるよう、改良した包装を長年にわたり模索してきました。



## タイベック®の特長:

- 引き裂き強度が高いため、ウェハー間を保護する合紙に適しています。
- リント(綿くず)がほぼ発生せず表面も滑らかなので、パーティクルや傷を防ぐのに役立ちます。
- 帯電防止処理を施しているため、静電気放電(ESD)を最小限に抑えるのに役立ちます。

## 品番:

- タイベック® 1025D, 1056D



DuPont™ Tyvek® Industrial Packaging  
[packaging.tyvek.com](https://www.tyvek.com)

総輸入販売元: 旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社

URL <https://www.tyvek.co.jp>

本資料に含まれる情報(「本情報」)は、デュポンが信頼できると考える技術データに基づいています。本資料は、新たな知識や経験が得られた場合には改訂されます。デュポンは本情報に関して結果を保証することなく、義務または責任を負うことも一切ありません。本資料は、自身の判断と責任において具体的な最終用途の条件に基づく評価を行うことのできる専門技術を持つ人が使用することを想定しています。そのため、利用条件は当社の関知するところではありません。当社は制約のない保証を含め、いかなる保証も明示もしくは暗示せず、特定の用途に関する商品性もしくは適合性を保証せず、本情報のいかなる使用に関しても責任を負いません。本資料は、素材やその利用方法の責任を負うデュポンまたはその他の機関の特許もしくは技術情報に基づく活動を許可すること、あるいはそれらの侵害を勧めることを意図していません。